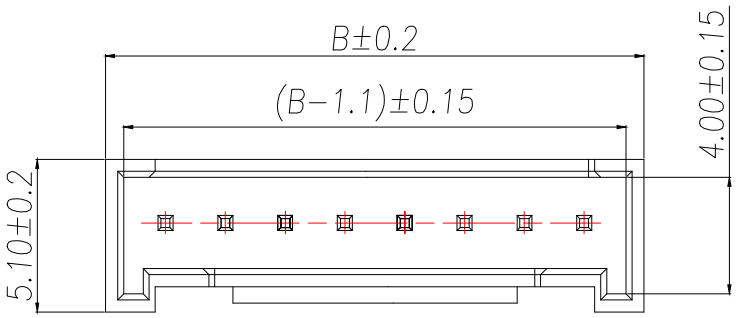
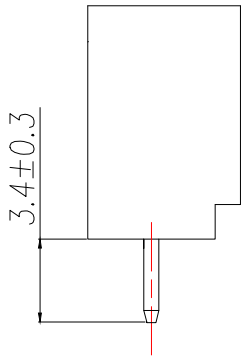




技术要求:

1.塑件材料:PA66(UL-94V-0)

2.接触件:黄铜镀锡

3.接触电阻:≤10mΩ

4.绝缘电阻:≥100MΩ

5.额定电压:250V AC DC

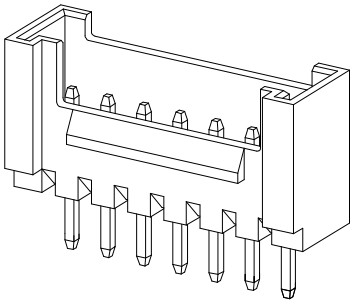
6.额定电流:2.0A AC DC

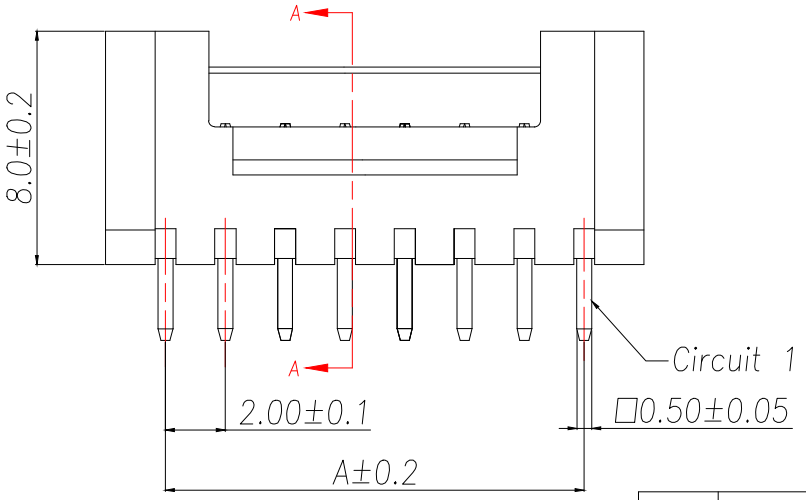
7.耐压:能承受1000V AC/Minute

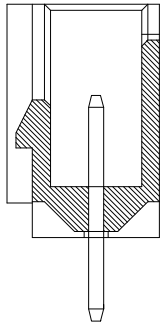
8.工作温度:-25°~+85°

9.可焊性试验:浸锡面积≥95%温度235$^{+5}_{0}$°,时间2.5±0.5秒

10.铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求.

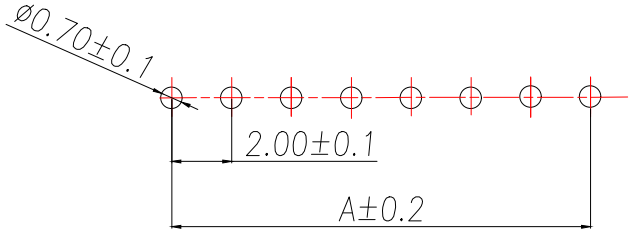






SECTION A-A

Part No	Pin	A	B
HY2.0-2PZZ	2	2.00	6.00
HY2.0-3PZZ	3	4.00	8.00
HY2.0-4PZZ	4	6.00	10.00
HY2.0-5PZZ	5	8.00	12.00
HY2.0-6PZZ	6	10.00	14.00
HY2.0-7PZZ	7	12.00	16.00
HY2.0-8PZZ	8	14.00	18.00
HY2.0-9PZZ	9	16.00	20.00
HY2.0-10PZZ	10	18.00	22.00
HY2.0-11PZZ	11	20.00	24.00
HY2.0-12PZZ	12	22.00	26.00
HY2.0-13PZZ	13	24.00	28.00
HY2.0-14PZZ	14	26.00	30.00
HY2.0-15PZZ	15	28.00	32.00



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

序号	名称	材料	数量	备注
2	端子Contact	黄铜	N*1	电镀(锡):整个表面镀底镍30u"MIN,再镀锡80u"MIN
1	基座Wafer	PA66(UL94V-0)	1	白色

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
.X±0.20	±2°
.XX±0.10	
.XXX±0.05	

制图 DRAWING	ROSE		
审核 CHECK	LEO		
核准 APPROVAL	JOHN		
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	BTC-HY2.0-N*PZZ	版本 REV.	A
品名 TITLE	WAFER HY2.0MM 直针	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			

深圳市宝通成电子有限公司